

<日本特許・実用新案明細書収録セット>

ホームページ公開中! <http://www.itdc-patent.com>

*最新の特許情報が満載!

貴金属メッキ方法と工程

[登録・公開編]平成19年(1年間) 88点

(税込価格)

(本体価格)

| | | | |
|----------------------|---------------|----------|----------|
| 全文PDF | CD-ROM版(抄録版付) | ¥28,875- | ¥27,500- |
| 全文紙収録 | B5製本版 | ¥28,875- | ¥27,500- |
| (CD-ROM版・B5製本版 一括購入) | | ¥43,050- | ¥41,000- |

既刊関連セットのご案内

(本体価格)

| No. | 登録・公開 | 既刊関連セットのご案内 | 年 | 点 | 本体価格 |
|----------|-------|--------------------|--------|-----|---------|
| No,10047 | 登録・公開 | 貴金属メッキ方法と工程 | 平.18 | 89点 | ¥27,700 |
| No,9920 | " | " | 平.17 | 84点 | ¥25,800 |
| No,9787 | " | " | 平.16 | 87点 | ¥23,400 |
| No,9642 | " | " | 平.15 | 76点 | ¥17,700 |
| No,9443 | " | " | 平.14 | 76点 | ¥17,700 |
| No,9255 | " | " | 平.13 | 74点 | ¥19,000 |
| No,9036 | " | " | 平.12 | 66点 | ¥23,100 |
| No,8811 | " | " | 平.11 | 76点 | ¥26,600 |
| No,8592 | " | " | 平.10 | 75点 | ¥27,000 |
| No,8350 | " | " | 平.9 | 74点 | ¥26,700 |
| No,8087 | 公告・公開 | " | 平.8 | 66点 | ¥23,400 |
| No,7949 | " | " | 平.7 | 72点 | ¥25,300 |
| No,7796 | " | " | 平.6 | 69点 | ¥24,800 |
| No,7672 | " | " | 平.5 | 64点 | ¥23,700 |
| No,7520 | " | " | 平.4 | 69点 | ¥24,700 |
| No,7299 | " | " | 平.3 | 66点 | ¥23,000 |
| No,8503 | " | 装飾用パラジウムメッキ方法 | 平.5-9 | 53点 | ¥20,700 |
| No,8497 | " | ハードディスク用基板のメッキ方法 | 平.5-9 | 66点 | ¥27,800 |
| No,8298 | " | ノン・シアン・メッキ方法と浴の組成 | 平.1-8 | 68点 | ¥29,700 |
| No,8295 | " | メタルアレルギー防止メッキ方法 | 平.5-8 | 62点 | ¥26,800 |
| No,9191 | " | メッキ用光沢剤の組成と光沢メッキ方法 | 平.9-12 | 60点 | ¥23,200 |

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります)

[CD-ROM版はPDFファイルにしておりリンク機能、B5製本版はB5サイズ・目次製本済みです。]

2~3日中に請求書同封の上お送り致します。]

お 申 込 書

| | |
|------|-------------------------------------|
| 会社名 | ご注文内容 |
| | ニュースガイド No. , CD-ROM版・B5製本版・一括購入 |
| 所属部署 | 題名 |
| | 合計 ¥ |
| 担当者名 | E-mail |
| | () Fax () |
| 住所 〒 | |

貴金属メッキ方法と工程

No.10157

[登録・公開編] 平成19年(1年間) 88点

CD-ROM版 ¥28,875

B5製本版 ¥28,875

(全て税込価格)

(CD-ROM版・B5製本版 一括購入 ¥43,050)

- | | | | |
|--|---|----------------------------------|--|
| 1 金めっき封孔処理剤と方法 | ユケン工業株式会社 | 30 複合被覆銅線及び複合被覆エナメル銅線 | 東京特殊電線株式会社 |
| 2 ストライプめっき条及びストライプめっき方法 | 富士電子工業株式会社 | 31 電気接点材料製造方法及び電気接点材料 | 株式会社東海理化電機製作所 |
| 3 セラミック電子部品のめっき方法、及びセラミック電子部品 | 株式会社村田製作所 | 32 電気接点材料製造方法及び電気接点材料 | 株式会社東海理化電機製作所 |
| 4 ストライプめっき用金属条、ストライプめっき条及びストライプめっき方法 | 日鉱富士電子株式会社 | 33 電気接点材料製造方法及び電気接点材料 | 株式会社東海理化電機製作所 |
| 5 金メッキ液及びその金メッキ液を用いたメッキ方法 | 日本エレクトロプレイティング・エンジニアーズ株式会社 | 34 シアン化物非含有銀系メッキ浴、メッキ体及びメッキ方法 | 石原薬品株式会社 |
| 6 錫又は錫合金めっき浴 | 株式会社大和化成研究所 | 35 電子部品用リード線及び該リード線よりのフラットケーブル | 株式会社三鈴 |
| 7 リードフレームのめっき方法 | 株式会社三井ハイテック | 36 多孔性金属薄膜およびその製造方法 | 国立大学法人東京農工大学 |
| 8 半導体集積回路装置の製造方法 | 株式会社ルネサステクノロジ | 37 疲労特性に優れた銅合金Auめっき条 | 日鉱金属株式会社 |
| 9 銀又は銀合金酸性電気めっき浴 | ディップソール株式会社 | 38 金属デュプレックス及び方法 | ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ, エル・エル・シー, 新日鉄マテリアルズ株式会社 |
| 10 非導体材料への表面処理方法 | 株式会社黒坂鍍金工業所 | 39 Cuコアボールとその製造方法 | エヌ・イーケムキャット株式会社 |
| 11 燃料電池用金属製セパレータおよびその製造方法 | 本田技研工業株式会社 | 40 バンプ形成用非シアン系電解金めっき浴 | エヌ・イーケムキャット株式会社 |
| 12 配線形成方法及び半導体装置 | 株式会社荏原製作所 | 41 き皮膜、電気めっき液及び電気めっき方法 | 学校法人早稲田大学 |
| 13 光沢のある金層および合金層を電着するための酸性浴および電着用光沢剤 | デグサ ガルヴァノテヒニク ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング | 42 プリント配線板及びその製造方法 | 日本シイエムケイ株式会社 |
| 14 マグネシウム系部材のメッキ製品およびその製造方法 | シチズン東北株式会社 | 43 金バンプ又は金配線の形成方法 | エヌ・イーケムキャット株式会社 |
| 15 かん合型接続端子用めっき材の製造方法 | 株式会社神戸製鋼所 | 44 ウィスカ抑制表面処理方法 | 上村工業株式会社 |
| 16 改良された下地皮膜を含む遮熱コーティング及び該遮熱コーティングで被覆した部材 | ソシエテ・ナショナル・デテユード・エ・ドウ・コンストリククシオン・ドウ・モートル... | 45 Pd / Snコロイド触媒吸着促進剤 | 荏原ユーザイト株式会社 |
| 17 金属基板表面における原子スケールの平坦面の形成方法 | 独立行政法人科学技術振興機構 | 46 被膜付きアルミニウム材 | アイシン高丘株式会社 |
| 18 非シアン系の金 - スズ合金メッキ浴 | 石原薬品株式会社 | 47 メッキ膜作製方法及び該方法によるメッキ膜を備えたメッキ製品 | 学校法人 名城大学 |
| 19 錫 - 銀合金めっき浴 | エヌ・イーケムキャット株式会社 | 48 電解めっき方法及び電解めっき装置 | 株式会社荏原製作所 |
| 20 工作部材および装置部品を非反応性被覆により選択的にまたは完全に不活性化する方法 | エンソーン インコーポレイテッド | 49 複合色彩装飾の作成方法およびそれを施した複合色彩装飾体 | 株式会社秀峰 |
| 21 メッキ引込線なしにメッキされるパッケージ基板の製造方法 | 三星電機株式会社 | 50 半導体リードフレームの製造方法 | 古河精密金属工業株式会社 |
| 22 電解硬質金めっき液及びそれを用いためっき方法 | エヌ・イーケムキャット株式会社 | 51 可動接点用銀被覆ステンレス条およびその製造方法 | 古河電気工業株式会社 |
| 23 錫 - 銀合金めっき皮膜を有する電子部品用リードフレーム及びその製造方法 | 松下電器産業株式会社 | 52 貴金属めっきを施したチタン又はチタン合金材料 | 日鉱金属株式会社 |
| 24 めっき品の背景着色法 | 本田技研工業株式会社 | 53 BGA型キャリア基板の製造方法及びBGA型キャリア基板 | 凸版印刷株式会社 |
| 25 リードフレーム | 株式会社三井ハイテック | 54 多層回路基板およびその製造方法 | 富士通株式会社 |
| 26 複合めっき材およびその製造方法 | DOWAホールディングス株式会社 | 55 コバルト - 白金合金磁性膜の製造方法 | 日本エレクトロプレイティング・エンジニアーズ株式会社 |
| 27 ダイレクトプレーティング方法及びパラジウム導電体層形成溶液 | 上村工業株式会社 | | |
| 28 イリジウムめっき液およびイリジウムめっき方法 | 日進化成株式会社 | | |
| 29 中空形状物品の内面メッキ方法及びその装置 | 和泉総業有限会社 | | |

以下33点省略